

股票代码：300128

股票简称：锦富技术

苏州锦富技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别“选中项请打√”	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他（电话会议）</div>
-------------------	---

2、在目前已经规模出货的液冷相关项目中，公司承担的具体角色是什么？

公司目前定位为液冷模组核心部件的机加工与制造方，覆盖外接式冷板、导流结构及相关金属部件，后续还将延伸至液冷模组的设计制造。公司不参与软管、快接头等系统集成环节，而是聚焦高精度加工、焊接与一致性交付。在多个项目中，公司实现单一项目内多部件同时承接，提升单机价值量，也增强了在客户体系中的不可替代性。

3、公司目前订单情况如何？产能情况如何，是否有扩产计划？

目前公司产能已经全线排满，已经完成新一轮的扩产，预计春节前可以投产。目前已经实现冷板及配套品类千万级别规模出货，预计年底投产后订单量级会有提升。

4、公司当前冷板方案在技术路径上与其他方案相比，有哪些差异？

公司采用的是小型化、贴近GPU布局的外接式冷板方案，更适配主流HGX服务器结构。与面向GB类大型准系统的超大尺寸散热板相比，该方案在空间利用率、系统适配性及部署灵活性方面更具优势。在结构上，冷板由铜质上下板与鳍片通过高压焊接形成密闭流道，冷却介质直接与内部鳍片接触，提升换热效率，适合当前主流B系列芯片的功耗水平。

5、公司如何看待当下液冷渗透率提升的确定性？

随着AI服务器单机功耗持续提升，传统风冷方案已逐步接近物理极限，目前来看英伟达、超威、摩尔线程、壁仞等国内外主流AI芯片均采用液冷方案，液冷在高端AI服务器中的应用具备很强确定性。

6、公司在微通道液冷技术上的布局进展如何？

在现有冷板方案基础上，公司已推进微通道液冷技术的研发。相较传统冷板，微通道通过显著缩小内部流道尺寸，提升单位面积的换热效率，以应对下一代更高功耗芯片需求。目前该技术仍处于验证与送样阶段，尚未形成量产贡献，但公司已完成关键制程能力的内部验证，为后续平台导入做准备。

7、微通道技术与 Rubin Ultra 平台的关系如何？

Rubin Ultra 被市场普遍视为下一代高端AI平台，其散热方案预计将从模组级升级至封装级液冷。在该技术路径下，微通道冷板需嵌入封装体系，对加工精度、焊接可靠性及良率控制提出更高要求。公司已参与相关前期测试与送样工作，并获得小量订单用于客户的试产验证。该平台仍处于设计与验证阶段，量产节奏取决于上游平台推进情况。

8、公司最核心的竞争力体现在哪？

公司核心竞争力在于深度融入台湾高端半导体与服务器产业链。公司与台湾客户A保持长期合作关系，参与其高端AI服务器液冷散热项目；同时，台湾客户A与台积电在先进制程与先进封装领域高度协同，使公司能够较早参与新技术验证。这种产业链层面的绑定，使公司在新平台导入阶段具备先发优势。

9、回到公司整体业务结构，传统业务与其他创新业务如何定位？

除液冷业务外，公司仍保有一定规模的传统金属加工业务，为整体经营提供稳定基础。同时，公司也在推进若干材料与结构类创新业务，技术属性较强、验证周期较长，目前体量

	尚小。 整体来看，传统业务提供稳定性，新业务提供弹性，而液冷业务是公司当前重点成长的方向。
附件清单（如有）	
日期	2025 年 12 月 17 日